

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 8 月 11 日 (11.08.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/073985 A1

(51) 国際特許分類⁷: H01B 5/00, 5/16, H01R 11/01

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/001058

(22) 国際出願日: 2005 年 1 月 27 日 (27.01.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2004-024063 2004 年 1 月 30 日 (30.01.2004) JP
特願2004-241571 2004 年 8 月 20 日 (20.08.2004) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 積水化学工業株式会社 (SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5308565 大阪府大阪市北区西天満 2 丁目 4 番 4 号 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 石田 浩也 (ISHIDA, Hiroya) [JP/JP]; 〒5288585 滋賀県甲賀市水口町泉 1 2 5 9 積水化学工業株式会社内 Shiga (JP). 脇屋 武司 (WAKIYA, Takeshi) [JP/JP]; 〒6188589 大阪府三島郡島本町百山 2-1 積水化学工業株式会社内 Osaka (JP). 上野山 伸也 (UENOYAMA, Shinya) [JP/JP]; 〒5288585 滋賀県甲賀市水口町泉 1 2 5 9 積水化学工業株式会社内 Shiga (JP).

(74) 代理人: 宮▼崎▲主税, 外(MIYAZAKI, Chikara et al.); 〒5400012 大阪府大阪市中央区谷町 1 丁目 6 番 5 号 西村ビル Osaka (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NL, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

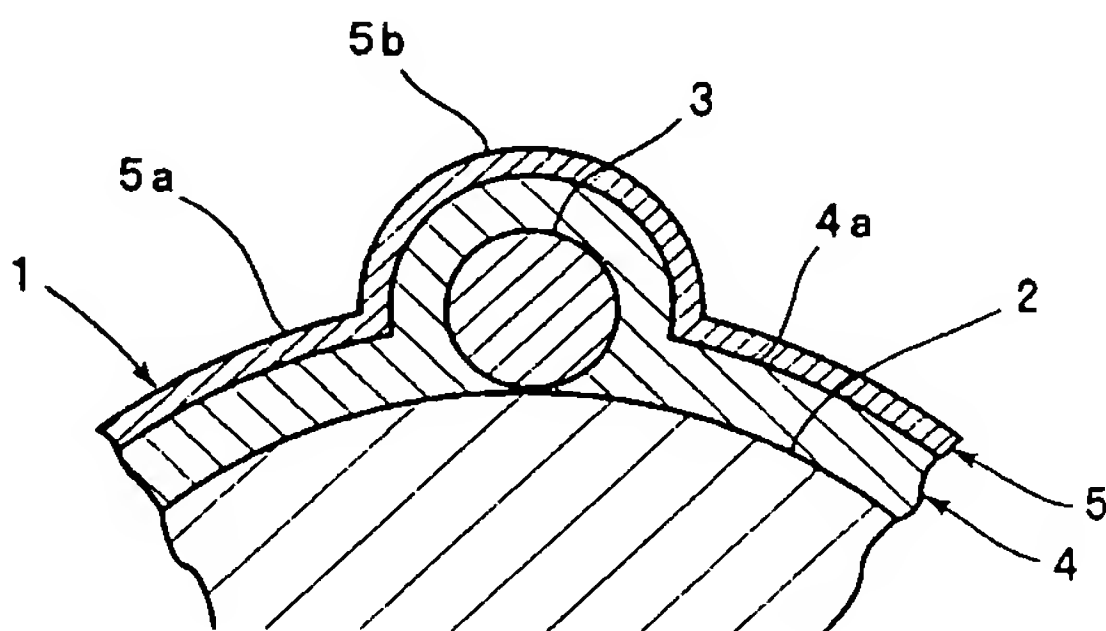
添付公開書類:

- 国際調査報告書
- 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受領の際には再公開される。

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: CONDUCTIVE PARTICLE AND ANISOTROPIC CONDUCTIVE MATERIAL

(54) 発明の名称: 導電性微粒子及び異方性導電材料



(57) Abstract: A conductive particle having a low connection resistance, a small variation of conduction performance, and excellent conduction reliability and an anisotropic conductive material using such particles are disclosed. Conventional anisotropic conductive materials using conductive particles are used in the form that they are interposed between opposed boards or between opposed electrode terminals of electronic devices such as mobile telephones. However, as electronic devices have been recently developing, enhancement of the conduction reliability of the conductive particles used for the anisotropic conductive materials have been required. The surface (2) of the base particle of a conductive particle (1) of the invention used for an anisotropic conductive material is covered with conductive films (4, 5). The conductive particle (1) has projections (5b) projecting from the conductive

films. A core material (3) for projecting the surface of the conductive films is provided on the surface of the base particle. The core material (3) is different from the conductive material of the conductive films. By thus using such conductive particles, the conduction reliability is enhanced.

[続葉有]

WO 2005/073985 A1